# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-39061

(P2002-39061A) (43)公開日 平成14年2月6日(2002.2.6)

(51) Int.Cl.7	徽別記号	FI	テーマコード(参考)
F 0 4 B 37/16		F 0 4 B 37/16	A 3H076
			D
F 0 4 C 18/16		F 0 4 C 18/16	C

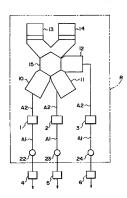
		審查請求	未請求 請求項の数5 OL (全 8 頁)
(21)出願番号	特額2000-224332(P2000-224332)	(71)出題人	391037386 大亜真空株式会社
(22) 出願日	平成12年7月25日(2000.7.25)		千葉県八千代市大和田新田495番地
		(71)出源人	000205041
			大見 忠弘
			宮城県仙台市青菜区米ケ袋2-1-17-
			301
		(72)発明者	阿久津 功
			千葉県八千代市大和田新田495番地 大亜
			真空株式会社内
		(74)代理人	100101878
			弁理士 木下 茂
			昌林可に続く

# (54) 【発明の名称】 真空装置

# (57)【專約】

【課題】 大きな排気速度のポンプを用いることなく所 望の排気速度を得ることができると共に、配管の内径を 小さくすることができ、配管を加熱する加熱手段の消費 電力を抑制することができる真空装置を提供する。

【解決手段】 ガス導入口とガス排出口を備える直空容 器10、11、12と、前記真空容器内部を減圧に保つ ための第1の真空ポンプ1、2、3と、前記第1の真空 ポンプに接続された第2の真空ポンプ4、5、6を備え る真空装置において、前記真空容器と第1の真空ポンプ との間の配管A2中の気体の流れが、分子流あるいは分 子流と粘性流の間の中間流となり、前記第1の真空ポン プ1、2、3と第2の真空ボンプ4、5、6との間の配 管A1中の気体の流れが、粘性流となるように構成され ている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ガス導入口とガス排出口を備える真空容 器と、前記真空容器内部を減圧に保つための第1の真空 ポンプと、前記第1の真空ポンプに接続された第2の真 空ボンプを備える真空装置において、

1

前記真空容器と第1の真空ボンプとの間の配管中の気体 の流れが、分子流あるいは分子流と粘性流の間の中間流 となり、前記第1の真空ポンプと第2の真空ポンプとの 間の配管中の気体の流れが、粘性流となるように構成さ れていることを特徴する真空装置。

【請求項2】 ガス導入口とガス排出口を備える真空容 器と、前記真空容器内部を減圧に保つためのターボ分子 ポンプあるいはねじ清ポンプと、前記ターボ分子ポンプ あるいはねじ満ポンプに接続された第1の真空ポンプ と、前記第1の真空ポンプに接続された第2の真空ポン プを備える真空装置において.

前記ターボ分子ポンプあるいはねじ溝ポンプと第1の真 空ボンプとの間の配管中の気体の流れが、分子流あるい は分子流と粘性流の間の中間流となり。 前記第1の直等 ポンプと第2の真空ポンプとの間の配管中の気体の流れ 20 る。 が、粘性流となるように構成されていることを特徴する 直空装置。

【請求項3】 前記第1の真空ボンプがスクリューボン プであることを特徴とする請求項1または請求項2に記 **敷された真空装置**。

【請求項4】 前記第1 2の真空ポンプがスクリュー ポンプであることを特徴とする請求項1または請求項2 に記載された真空装置。

【請求項5】 前記スクリュー真空ポンプは、雄雄ロー タを構成する歯車のねじれ角が連続的に変化し、雄雄ロ 30 6a、16b、17a、17b、18a、18bと、低 タとケーシングとにより形成される作動室の容積が、 吸入ポートから叶出ボートに進行するにつれて連続的に 減少するように構成されていることを特徴とする請求項 3または請求項4に記載された真空装置。 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の屋する技術分野】本発明は半導体、液晶ディス プレイ製造分野等において用いられる真空装置に関し、 特に、配管内径を小さくでき、消費電力を抑制すること ができる真空装置に関する。

# [0002]

【従来の技術】半導体、液晶ディスプレイ製造分野のほ か、多くの産業分野で、真空装置が用いられている。こ の真空装置は、一般的に真空容器と、前記真空容器内部 を真空あるいは減圧状態に保つ真空ボンプとを備えてい る。そして、前記真空装置はクリーンルーム内に配置さ れると共に、真空容器内に、所定の処理ガスを導入、排 出しながら、所定の処理を行うように構成されている。 【0003】半導体製造装置に用いられている従来の真 空装置を図6に基づいて説明する。この真空装置は、複 50 【0008】その後、反応チャンバ(真空容器)10と

数の反応チャンバ (真空容器) 10、11、12と、前 記反応チャンバ(真空容器) 10、11、12内部を減 圧あるいは真空状態になすために、各反応チャンバ(真 空容器) 10、11、12にそれぞれ1台あるいは複数 台配置された高真空ポンプ16a、16b、17a、1 7b、18a、18bと、前記高真空ボンブの後段に配 置された低真空ボンプ19、20、21とを備えてい

2

【0004】また、前記高真空ポンプ16a、16b、 10 17a、17b、18a、18bと、低真空ポンプ1 9、20、21との間には、バルブ22a、22b、2 3a、23b、24a、24bが設けられている。 更 に、前記反応チャンバ(真空容器)10、11、12に ウエハ等の被処理物を掛入するためのロードロックチャ ンバ13、14と、ロードロックチャンバ13に搬入さ れた被処理物を反応チャンバ10、11、12に移送 し、また反応チャンバ10、11、12からロードロッ クチャンバ14に移送するロボット(搬送装置)が収容 されているトランスファチャバ15とが設けられてい

【0005】また、図示しないが、ロードロックチャン バ13、14、トランスファチャバ15にも真空ポンプ が接続され、減圧あるいは真空状態になすことができる ように構成されている。更に、反応チャンバ(真空容 器) 10、11、12には、図示しないが、ガス導入口 及びヒータ等の加熱手段が設けられており、加熱下で所 定のガスを導入しながら、成膜等の所定の処理がなされ るように構成されている。

【0006】なお、図中のB1は、前記高真空ポンプ1 真空ポンプ19、20、21との間の配管を示し、B2 は、反応チャンバ(真空容器) 10.11.12と前記 高真空ポンプ16a、16b、17a、17b、18 a、18bとの間の配管を示している。また、配管B1 、B2 の内部は、成膜ガス等の処理ガスが通過するた め、生成堆積物が付着する、これを防止するため、配管 B1 B2 にはヒータ等の加熱手段が設けられ、所定の 温度に加熱されている。

【0007】この真空装置が待機した状態にあっては、 40 トランスファチャバ15、反応チャンバ(真空容器)1 11.12は減圧あるいは直空状態に維持されてい る。そして、装置外部の大気中から複数のウエハ等の被 処理物を入れたカセットがロードロックチャンバ13に 搬入され、前記ロードロックチャンバ13が真空引され る。次に、ロードロックチャンバ13とトランスファチ ャバ15の間のゲート弁(図示せず)が開き、被処理物 搬送用ロボットが搬送アームによりカセット内の被処理 物を一枚取り出してトランスファチャバ15に移動させ

トランスファチャバ15間のゲートを開け搬送アームに より被処理物を反応チャンバ(真空容器)10内のステ ージ上に載置する。そして、成膜処理等の所定の処理 後、処理された被処理物は、搬送アームにより他の反応 チャンバ11、12、あるいはロードロックチャンバ1 4に搬送される。そして処理が終了した後、最終的にロ ードロックチャンバ14から外部に搬送される。

3

【発明が解決しようとする課題】ところで、前記高真空 ボンプとして、一般的には到達真空度(10-7torr 10 【0013】このように、第1の真空ボンプと第2の真 以下)の分子領域で動作する高真空ボンブが用いられて いる。この高真空ボンプとしては、一般的にターボ分子 ポンプあるいはねじ清ポンプが用いられている。このポ ンプは、小型のものでも排気速度が大きいが、許容背圧 が1 t o r r 以下と小さい。そのため、前記高真空ポン プの後段に、到達真空度が低く、背圧が大気圧程度で動 作する低真空ポンプが設けられている。この低真空ポン プとしては、一般的にルーツボンプ等のドライボンプが 用いられている。このように、高真空ボンブの許容背圧 がO、5torr以下、具体的には、O.4torr程 20 度であるため、前記高真空ボンプと低真空ボンプとの間 の配管 B1 の内部の気体の流れは分子流、あるいは分子 流と粘性流の間の中間流となる。したがって、効率よ く、排気を行うためには配管B2の内径のみならず、配 管B1 の内径をある程度大きくする必要があった。具体 的に述べると、配管B1 、B2 の内径は、80mm程度 が望ましいが、従来の配管は内径が40~50mm程度 で、コンダクタンスが小さくなり、排気速度を低下させ ている。

【0010】一方、配管B1、B2の内部は成膜ガス等 30 本発明にかかる真空装置は、ガス導入口とガス排出口を の処理ガスが通過するため、生成堆積物が付着する。こ れを防止するため、配管B1 . B2 にはヒータ等の加熱 手段が設けられ、所定の温度に加熱されている。そのた め、従来の真空装置において、配管の内径を大きくする と、配管を加熱するためのヒータ等の加熱手段の消費電 力が大きく、運転コストが崇むものであった。また、配 管の径が大きいとその配管作業は困難であり、しかも大 きな設置スペースが必要となる。そのため、必要以上に 大きな排気速度のポンプを使用して配管内径を40~5 Ommとしている。特に、高真空ボンプと低真空ボンプ 40 との間の配管が長いため、上記した占が問題となってい

【0011】本発明はかかる課題を解決するためになさ れたものであり、大きな排気速度のボンプを用いること なく所望の排気速度を得ることができると共に、配管の 内径を小さくすることができ、配管を加熱する加熱手段 の消費電力を抑制することができる真空装置を提供する ことを目的とするものである。

# [0012]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため 50 プの消費電力を抑えることができる。更に、配管の内径

になされた本発明にかかる真空装置は、ガス導入口とガ ス排出口を備える真空容器と、前記真空容器内部を減圧 に保つための第1の真空ボンプと、前記第1の真空ボン プに接続された第2の真空ポンプを備える真空装置にお いて、前記真空容器と第1の真空ポンプとの間の配管中 の気体の流れが、分子流あるいは分子流と粘性流の間の 中間流となり、前記第1の真空ポンプと第2の真空ポン プとの間の配管中の気体の流れが、粘性流となるように 構成されていることを特徴としている。

4

空ボンプとの間の配管中の流れが粘性流であるため、配 管の内径が小さい場合であっても、効率的に排気するこ とができる。また。第1の直空ボンプと第2の直空ボン プとの間の配管中の流れが粘性流であるため、第2の真 空ボンプとして小型のものを用いることができ、第2の 真空ボンプの消費電力を抑えることができる。また、第 1のポンプも真空中での動作となり、消費電力を抑える ことができる。更に、配管の内径を小さくすることがで さるため、加熱する加熱手段(ヒータ)の消費電力を抑 制することができ、しかも設置スペースを小さくするこ とができる。特に、第1の真空ボンプと第2の真空ボン プとの間の配管中の流れが20torr以上の粘性流と なすことが、第2の真空ボンプとしてより小型のものを 用いることができ、第2の直空ボンプの消費電力を抑え ることができる点から、より好ましい。ここで、分子流 とは、10<sup>-3</sup>torr以下の気体の流れをいい、粘性流 とは、1 t o r r 以上の気体の流れをいい、また中間流 とは、1~10-3 torrの気体の流れをいう。

【0014】また、上記目的を達成するためになされた 備える直空容器と、前記直空容器内部を減圧に保つため のターボ分子ポンプあるいはねじ潰ポンプと、前記ター ボ分子ポンプあるいはねじ濃ポンプに接続された第1の 真空ボンプと、前記第1の真空ボンプに接続された第2 の真空ボンプを備える真空装置において、前記ターボ分 子ボンプあるいはわじ満ポンプと第1の直空ポンプとの 間の配管中の気体の流れが、分子流あるいは分子流と粘 性流の間の中間流となり、前記第1の真空ポンプと第2 の真空ポンプとの間の配管中の気体の流れが、粘性流と なるように構成されていることを特徴としている。

【0015】このように、直空容器に接続されたターボ 分子ボンプあるいはねじ溝ボンプに第1の真空ボンプを 接続し、更に第1の真空ポンプに第2の真空ポンプを接 続した構成を備え、第1の真空ボンプと第2の真空ボン プとの間の配管中の気体の流れが、粘性流となるように 構成されている。そのため、第1の直空ボンブと第2の 真空ボンプとの間の配管の内径を小さくすることがで き、効率的に排気することもできる。第2の真空ボンブ として小型のものを用いることができ、第2の真空ボン

を小さくすることができるため、加熱する加熱手段(ヒ ータ)の消費電力を抑制することができる。特に、第1 の真空ボンプと第2の真空ボンプとの間の配管中の流れ が20 torr以上の粘性流となすことが、第2の真空 ボンプとしてより小型のものを用いることができ、第2 の真空ポンプの消費電力を抑えることができる点から、 より好ましい。

【0016】また、前記第1の真空ポンプが、スクリュ ーポンプであることが望ましく、また第1、2の真空ポ ンプはスクリューボンプであることが望ましい。第1の 10 なるように設定される。 真空ポンプ (スクリューポンプ) の許容背圧が高いた め、第1の真空ボンプ以降の配管内の流れを粘性流とな すことができる。その結果、前記したように、第1の真 空ボンブ以降の配管の内径が小さい場合であっても、効 率的に排気することができる。また、配管の内径を小さ くすることができるため、加熱する加熱手段(ヒータ) の消費電力を抑制することができ、設置スペースを小さ くすることができる。

【0017】特に、前記スクリュー真空ボンプは、雄雄 ロータを構成する歯車のねじれ角を連続的に変化し、雄 20 43に取りつけられた軸受44、45と副ケーシング4 雄ロータとケーシングとにより形成される作動室の容積 が、吸入ボートから吐出ボートに進行するにつれて連続 的に減少するように構成されていることが望ましい。こ のように、雄惟ロータを構成する歯重のねじれ角を連続 的に変化させたスクリュー真空ポンプは、高真空度を得 ることができると共に 許容背圧が高いため 第1の真 空ポンプとして用いるのに適している。

#### [0018]

【発明の実施の形態】本発明にかかる真空装置の第一の 実験形態を図1万至図3に基づいて説明する。なお、従 30 ングギャ51、52を介して雌ロータ41を回転させる 来の真空装置と同一あるいは相当する部材には、同一符 号を付することにより、その説明を省略する。従来の真 空装置との比較において、本発明にかかる真空装置は、 図1に示すように、反応チャンバ (真空容器) 10、1 1、12に接続される第1の真空ボンプ(高真空ボン プ) 1. 2. 3がスクリューボンプであり、その第1の 直空ポンプ (スクリューポンプ) 1.2.3の後段に、 スクリューボンプからなる第2の真空ボンプ (低真空ボ ンプ) 4、5、6が配置される点に特徴がある。

【0019】また、反応チャンバ(真空容器)に接続さ 40 れる第1の直空ポンプ1、2、3は、それぞれの反応チ ャンバ(真空容器)ごとに1つのスクリューポンプが接 続され、前記第2の真空ポンプ(低真空ポンプ)4. 5、6は、第1の真空ボンプ1、2、3と、バルブ2 2、23、24を介して接続されている。

【0020】また、直空容器の容量、圧力状態によって 異なるが、一般的に第1の真空ポンプは、排気速度20 00リットル/min、到達圧力5×10<sup>-4</sup>torr、 許容背圧20 torrの性能を有するスクリューポンプ が用いられる。また、同様に、一般的に第2の真空ボン 50 タイミングギヤ51、52によって雌ロータ41が回転

6 プは、排気速度数100リットル/min. 到達圧力1 0-2 torr程度の性能を有するスクリューボンプが用 いられる。

【0021】また同様に、真空容器の容量、圧力状態に よって異なるが、一般的には、反応チャンバ(真空容 器) と第1の真空ボンプ1、2、3との間の配管A2の 圧力は、10<sup>-2</sup> torr程度であり、第1の真空ボンプ 1、2、3と第2の真空ポンプ(低真空ポンプ)4、 5、6との間の配管A1の圧力は、20torr程度に

【0022】ここで、特に重要なことは、第1の真空ボ ンプ1、2、3と第2の真空ポンプ(低真空ポンプ) 4、5、6との間の配管A1内の気体の流れが粘性流に なるように、配管の圧力が設定されることである。 【0023】次に、ここで用いられる一般的なスクリュ ー真空ボンプの構造について、図2、3に基づいて説明 すると、図に示すように、このスクリュー真空ポンプの 雄ロータ40と雌ロータ41は、主ケーシング42に収 納され、前記主ケーシング42の一端面を密封する端板 6に取りつけられた軸受47、48とにより回転自在に 支持されている.

【0024】前記雄雄ロータ40、41の回転軸49、 50には、副ケーシング46内に収納されたタイミング ギャ51、52が取付られ、雄雄ロータ40、41が互 いに接触しないように面ロータ間の隙間が無整されてい る。また、前記雄ロータ40の同転動49には カップ リングまたは増速用ギャを介してモータMが取り付けら れ、モータMの回転は雄ロータ40に伝達され、タイミ ように構成されている.

【0025】また、前記軸受44、45の潤滑は飛まつ 給油により行うため、副ケーシング46内に溜った潤滑 油 (図示せず)をタイミングギヤ51、52によって跳 ねかけるようになされている。そして前記軸受44、5 5にはシール材53、54が取りつけられ、前記シール 材53.54によって潤滑油が作動室内へ侵入するのを 防いでいる。

【0026】前記主ケーシング42の一端側には、吸入 口56が設けられて副ケーシング55が取り付けられて いる。また前記主ケーシング42の壁板43には雄雄ロ -タ40.41で圧縮された気体を外部に叶出する叶出 ロ57が設けられている。尚、主ケーシング42の外側 には気体の圧縮により温度が上昇するため、冷却ジャケ ット58が設けられ、このジャケット内に冷却水を通し ケーシング42や圧縮気体を冷却するように成されてい

【0027】このように構成されたスクリュー真空ポン プは、モータMにより雄ロータ40を回転駆動すると、

駆動される。そして、雄、雄ロータ10、11の回転に 伴い気体が吸入口56から雄ロータ40と雌側ロータ4 1とケーシング42とによって形成される作動室に吸い 込まれる。吸い込まれた気体は、推雌ロータ40、41 の回転に伴い、圧縮されながら吐出口57から吐出され

【0028】前記したスクリュー式真空ボンプは、図に 示すように、雄ロータ40と雄ロータ41は主ケーシン グ42と吐出ケーシング43内の軸受44、45、4 タ40と雌ロータ41はねじ歯車からなり、この歯車は 歯すじねじれ角は常に一定の角度であって、切り口法線 ピッチ及び軸直角ピッチも一定であって、前記ロータ4 0、41の回転角の変化に伴って変化しない。

【0029】即ち、前記雄ロータ40と雌ロータ41 は、歯すじねじれ角は常に一定の角度であって、切り口 法線ピッチ及び軸直角ピッチも一定のねじ歯車で構成さ れるため、ロータとケーシングにより形成されるV字形 の作動室の容積は一定である。しかし、ロータが回転 ート57へ向かって移動すると、ケーシング42の吐出 ケーシング43によって作動室の容積は減少するため、 気体を圧縮排気する。

【0030】なお、上記スクリューボンプの代わりに、 前記雄雄ロータを構成する歯車のねじれ角を連続的に変 化させることにより 雄雄ロータとケーシングとにより 形成される作動室の容積が、吸入ポートから吐出ポート に進行するにつれて連続的に減少するように構成したス クリューボンプを用いることが、より好ましい。このス クリューポンプについては、本願出願人によって既に提 30 塞されているものであり、特開平9-32766号公報 に詳しく述べられている。

【0031】この提案したスクリュー真空ボンプによれ ば、前記雄ロータと雄ロータの歯すじねじれ角がロータ の回転角にしたがって変化するため、ロータとケーシン グにより形成されるV字形の作動室の容積は 吸入ポー トから叶出ポートに進行するにつれて連続的に減少す る。したがって、前記雄雄ロータとケーシングとにより 形成される作動室は、吸入、内部圧縮移送、吐出作用を ないため、局部的な圧力上昇による異常な温度上昇を防 止することができると共に、効率的な運転を行うことが できる。しかも、ねじれ進行方向の切り口法線ピッチを 変化させたため、スクリューボンブの小型化が図られ る。また消費電力を抑えることができる。

【0032】その結果、このスクリューボンプを用いた 真空装置のより小型化が図られ、クリーンルーム内のス ベースの有効利用が図られる。なお、前記提案されたス クリュー真空ボンプの性能は、排気速度2800リット ル/min、到達圧力5×10<sup>-5</sup>torrであり、高真 50 の矢印は、空気の流れを示している。

空が可能であり、また許容背圧が高いため、第1の真空 ボンプとして用いるのに適している。

【0033】次に図4、図5に基づいて、本発明にかか る真空装置の第2の実施形態について説明する。この実 施形態にあっては、図4に示すように、高真空ボンプ1 6a、16b、17a、17b、18a、18bと低真 空ポンプ19、20、21との間に、新たに中真空ポン プ7、8、9を設けて、分子流、あるいは分子流と粘性 流の間の中間流となる領域(配管B」)を短く構成した 7、48により回転自在に支えられている。前記雄ロー 10 ものである。なお、図4中、図6に示された部材と同一 部材は、同一符号を付し、その説明は省略する。

【0034】このように構成することによって、図4に 示した中真空ボンプ7、8、9と低真空ボンプ19、2 0、21との間(配管A<sub>1</sub>)を粘性流とすることによ り、効率的に排気を確保しつつ、中真空ボンプ7、8、 9と低真空ボンプ19、20、21との間の配管A: の 内径を小さくすることができる。また、粘性流であるた め、第2の真空ボンプとして小型のものを用いることが でき、第2の真空ボンプの消費電力を抑えることができ し、両ロータの噛み合い部は吸入ボート56から吐出ボ 20 る。また、第1の真空ボンプも真空中での動作となり消 曹電力を抑えることができる。更に、配管A:の内径を 小さくすることができるため、加熱する加熱手段(ヒー タ)の消費電力を抑制することができる。

> 【0035】また、高真空ボンプ16a、16b、17 a、17b、18a、18bとしては、従来から用いら わている 例えばターボ分子ポンプあるいほわじ溝ボン プが用いられる。また、低真空ボンプ19、20、21 としては、一般的なルーツボンプ付ドライボンプが用い られる。なお、低真空ポンプ19、20、21として、 スクリューボンプを用いても良い。更に、中真空ボンプ 7.8.9は 前記した推権ロータを構成する歯車のわ じれ角を連続的に変化し、維維ロータとケーシングとは より形成される作動室の容積が、吸入ボートから叶出ボ トに進行するにつれて連続的に減少するように構成さ れたスクリューポンプが望ましい。

【0036】この第2の実施形態にあっては、中間直空 ポンプが用いられるため、設置スペースが大きくなり、 装置自体も高価になる。また、図5に示すように、反応 チャンバ、トランスファチャンバ、ロードロックチャン 有し、作動室の容積を一定とした単なる移送作用を有さ 40 パ等のクラスターツール28は、クリーンルームRに配 置され、直空ポンプ29はクリーンルームRの下部に配 置される。そのため、真空ポンプが占有する部分29の 面積が、クラスターツール28の面積よりも大きい場合 には、クリーンルームRの上部にいわゆるデットスペー スDが形成される。したがって、クリーンルームRの有 効利用、経済性を考慮すれば、第1の実施形態がより好 ましい。なお、図1、図4に示された仮想線はクリーン ルームRを示している。図5に示された符号30は、フ ィルターであり、符号31は空調システムであり、図中

【0037】次に、図1と図6に示された真空装置をウ エハの成膜処理に用いた場合による配管の内径を比較す 3.

(実施例)図1に示す前記反応チャンバ(真空容器)1 0の容積は50リットルとして、ガス導入口から毎分1 リットルのガスを供給すると共にガスを排出し、その内 部を0.4torrの減圧状態になす。また、真空装置 内部は図示しないがチャンバは加熱手段により、150 ℃程度に維持される。また、この反応チャンバ(真空容 器)に接続されているスクリューボンプ1は、上記した 10 るので、粘性流配管コンダクタンスにより排気速度が低 ねじれ角がロータの回転角にしたがって変化するもので あり、その性能は、排気速度2800リットル/mi n、到達圧力5×10-5torrのものを用いた。ま た、前記スクリューポンプ1に接続されているスクリュ ーポンプ4は、一般的なスクリューポンプであり、その 性能は、排気速度100リットル/min、到達圧力1 O-2 t o r r 程度のものを用いた。

【0038】このときの、図1に示した配管A2の長さ を、O.5mその内径を、50mmmmとした。また、 配管A1 の長さを、5mその内径を、20mmとした。 この状態で、配管A1、配管A2の内圧を測定したら、 配管A1 のスクリューボンプ1側内圧は8torrで粘 性流であり、配管 A: のポンプ側の内圧は0.28to rrで中間流であることが認められ、配管A:の内径が 20mmとしても十分に排気することができることが認 められた.

【0039】(比較例)図6に示す前記反応チャンバ (真空容器) 10の容積は、図1と同様は、50リット ルであり、ガス導入口から毎分1リットルのガスを供給 すると共にガスを排出し、その内部を0.4torrの 30 減圧状態になす。また、直空装置は加熱手段により 1 50℃程度に維持される。また、この反応チャンバ(真 空容器)10に接続されているねじ溝ポンプ16a、1 6bの性能は、450リットル/secであり、前記ね じ溝ボンプ16a、16bに接続されているドライボン プ (ルーツポンプ) 19の性能は、排気速度4000リ ットル/minである。

【0040】このときの、図6に示した配管B: の長さ を、5mその内径を、50mmとした。なお、配管B<sub>2</sub> は、ねじ溝ポンプ16a、16bが反応チャンバ(真空 40 A) 容器) に近接して設けられるため、配管B2 の長さは、 実質的にゼロである。この状態で、配管B」のねじ溝ボ ンプ側の内圧を測定したら、配管B: の内圧は0.6 t

orrで中間流であることが認められた。また、十分な 排気を行うためには、配管B1 の内径を80mm以上と することが必要であることが認められた。

【0041】以上の比較から明らかなように、図1に示 したスクリューボンプを用いた真空装置にあっては、配 管の内径を図6の場合に比べて小さくすることができる ことが認められた。

[0042]

【発明の効果】本発明は以上述べたように構成されてい 下しないため、大きな俳気速度のボンプを必要とせず消 曹電力を抑制することができる。また、配管の内径を小 さくすることができ、配管を加熱するヒータの消費電力 を抑制することができ、維持費の削減につながる。 【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本発明の一実施形態を示す概略構成図 である。

【図2】図2は、本発明の一実施形態に用いられるスク リューポンプの構成を示す機略平面図である。

20 【図3】図3は、図2に示されたスクリューポンプのA A断面図である。

【図4】図4は、本発明の他の実施形態を示す概略構成 図である。

【図5】図5は、クリーンルームの概略構成図である。 【図6】図6は、従来の真空装置を用いたクラスターツ ールの概略機成団である。 【符号の説明】

1 スクリューポンプ (第1の真空ポンプ) スクリューポンプ (第1の真空ポンプ)

3 スクリューポンプ (第1の真空ポンプ) スクリューポンプ (第2の直空ポンプ)

スクリューポンプ (第2の真空ポンプ)

6 スクリューポンプ (第2の真空ポンプ) 7 スクリューボンプ (第1の真空ボンプ)

8 スクリューボンプ (第1の真空ボンプ) 9 スクリューポンプ (第1の直空ポンプ)

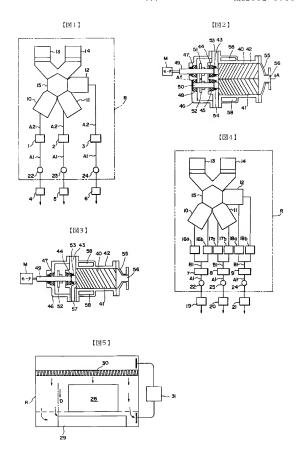
1.0 反応チャンバ (真空容器)

11 反応チャンバ (真空容器)

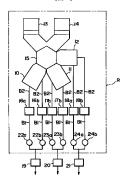
12 反応チャンバ (真空容器)

配管 A<sub>2</sub> 配管

R クリーンルーム



【図6】



フロントページの続き

(72)発明者 大見 忠弘 宮城県仙台市青葉区米ヶ袋2の1の17の 301 (72)発明者 平山 昌樹

宫城県仙台市青葉区荒巻字青葉05東北大学

大学院工学研究科電子工学専攻内 (72)発明者 相澤 憲司

宮城県仙台市太白区八木山弥生町22の34 Fターム(参考) 3H076 AA16 AA21 AA37 BB21 BB38 BB43 CC07 CC94 CC95 CC99